

國家科學及技術委員會新聞稿附件

第 34 次園區審議會核准投資案

一、浩登智能科技股份有限公司(設立於新竹科學園區之宜蘭園區)

本案投資金額 0.2 億元，公司產品為基於微服務架構建構的「智慧物流與製造協同作業系統」，透過軟硬解耦技術，將傳統僵化的倉儲設備轉化為具備 AI 自主決策能力的動態資源，並提供智慧倉儲管理系統、物料與設備控制系統、智慧自主決策引擎、3D 數位孿生看板、智能物流顧問與整合等服務。

本案以「軟體定義物流」為核心定位，整合 WebWMS、WCS/MCS、AI Agent、Digital Twin 與智慧物流顧問服務，符合智慧製造、工業 4.0、供應鏈韌性與高階自動化之產業需求。其優勢在於結合 IT 與 OT，強調跨品牌設備、跨廠區倉儲、低延遲控制、即時派工、路徑最佳化、庫存可視化與數位孿生監控，對臺灣半導體、PCB、精密零組件、電子製造及第三方物流具有極大應用價值。

本案符合政府「六大核心戰略產業」之智慧製造與資訊安全等政策，有助提升國內自動化硬體廠商的附加價值，擴大智慧物流與製造之整體競爭力。

二、亞智科技股份有限公司南科分公司(設立於南部科學園區之臺南園區)

本公司主要研發先進封裝設備開發及系統整合解決方案，公司長期深耕化學濕製程、電化學沉積(ECD)、自動化整合及智慧製造等核心技術，規劃於臺南園區設置研發中心，聚焦次世代先進封裝設備開發，產品涵蓋玻璃通孔蝕刻設備及雙面電鍍設備，可滿足人工智慧、高效能運算及面板級封裝等市場需求。未來進駐園區後，公司將持續貼近客戶需求，深化共同研發與技術驗證，帶動半導體關鍵設備在地化與國產化，提升產業國際競爭力。

三、新台實業股份有限公司(設立於中部科學園區之臺中園區)

本案投資金額 0.15 億元，主要產品為半導體設備硬體與製程改善優化、半導體二手設備機台翻新、次世代半導體高純度矽耗材零組件、先進原子層沉積(ALD)製程腔體設計製造。

新台實業主要專注於半導體設備的 ASM 前端製程設備半導體的爐管(Furnace)、磊晶(Epitaxy)、化學氣相沉積(CVD)及原子層沉積(ALD/PEALD)等高階設備與關鍵零組件，具備從基礎零件維修到最高階「二手機深度翻新買

賣並提供原廠級一年保固」之全線技術服務量能。公司廠內常備半導體設備實機驗證平台，所有零組件與機台出廠前均經 100%實機匹配測試，確保隨裝即產；並提供半導體高純度矽的晶圓乘載舟(Boat)與矽晶噴嘴(Injector)耗材零組件、晶圓機械手臂 (ROBOT) 維修、高階量測校正檢測晶圓盒 (Robot Measurement Cassette , RMC)；本案進駐中部科學園區，將整合國際情報與國內產學研研發能量，在園區建構具備永續減碳效益的自主技術鏈，實質強化臺灣半導體高階核心供應鏈之在地化韌性。

四、丰榮智機股份有限公司（設立於中部科學園區之臺中園區）

本案投資金額 0.5 億元，主要產品為半導體晶圓成品智慧包裝與晶圓傳送盒檢測設備、物流與倉儲自動化解決方案，以及半導體封裝測試製程自動化設備。

丰榮智機專注於智慧自動化設備研發與系統整合，推出整合高精度搬運與 AI 視覺檢測的晶圓成品包裝系統。透過自主開發的 FOUP/FOSB 傳送盒夾持設計，有效降低晶圓損傷風險並提升出貨效率。針對廠區物流，公司結合微型自動倉儲、自主移動機器人與智慧倉儲管理系統，實現無人化物流與自動入庫管理。面向智慧製造新世代，丰榮智機整合精密搬運、AI 視覺與製造執行系統資訊串接，打造高可靠度的客製化解決方案。旗下核心設備通過 SEMI S2/S26 國際安全認證，積極落實政府設備國產化與供應鏈自主化政策，全面驅動半導體產業整廠智慧製造升級。